

PROGRAMMKOMMISSION

Vorsitzender der Programmkommission

U. Bechtloff, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf

Wissenschaftlicher Tagungsleiter

K.-D. Lang, FhG-IZM, Berlin

Mitglieder

H.-J. Albrecht, Siemens AG, Berlin
A. Biener, Freudenberg Mektect Europe GmbH, Weinheim
J. Denzel, EADS Deutschland GmbH, Ulm
R. Dietrich, Lackwerke Peters GmbH + Co. KG, Kempen
M. Eisenbarth, Continental Teves AG & Co., Ingolstadt
W. Grönig, Arden-Verfahrenstechnik GmbH, Velbert
J. Kostelnik, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Rot
S. Mahlstedt, DVS e.V., Düsseldorf
J. Mahrle, Daimler AG, Sindelfingen
E. Maiser, VDMA e.V., Frankfurt
R. Myllylä, Universität Oulu, Finnland
J. Nicolics, Technische Universität Wien, Österreich
M. Nowotnick, Universität Rostock
R. Schließer, VDI/VDE-Innovation+Technik, Berlin
G. Schmitz, Robert Bosch GmbH, Stuttgart
R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Frankfurt
R. Schulze, BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa
H. Schweigart, Dr. O.K. Wack Chemie GmbH, Ingolstadt
J. Stahr, AT & S, Leoben-Hinterberg, Österreich
H. van 't Hoen, Wirges
J. Weber, Zollner Elektronik AG, Zandt
M. Weinhold, PBW Consulting Weinhold, Königswinter
M. Weinreich, DVS e.V., Düsseldorf
C. Weiß, ZVEI, Frankfurt
J. Wilde, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
K. J. Wolter, Technische Universität Dresden
K. Wundt, EIPC, Maastricht, Niederlande

KONFERENZSEKRETARIAT

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und
Feinwerktechnik (GMM)
Stresemannallee 15
Tel.: 069-6308 - 227
Fax: 069-6308 - 9828
E-Mail: gmm@vde.com
www.ebl-fellbach.de

PARTNER



Elektronische Baugruppen und Leiterplatten



Call for Papers

Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2012

Hochentwickelte Baugruppen
aus Europa

6. DVS/GMM-Tagung

14./15. Februar 2012

Schwabenlandhalle Fellbach

www.ebl-fellbach.de

Titelbild: Hochfrequenzbaugruppe in COB-SMD-Technologie
(Kooperation Fraunhofer IZM, Humboldt Universität Berlin, IHP
Frankfurt)

DVS
DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN

GMM

ZIELSETZUNG DER TAGUNG

EBL 2012

Elektronische Baugruppen und Leiterplatten – Hochentwickelte Baugruppen aus Europa

Integrationstechnologien auf der Baugruppenebene haben zur Herstellung hochwertiger Systeme weltweit eine enorme Vielfalt entwickelt. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch Handheld-Geräte und die Mobilkommunikation. Beispielhaft hierfür stehen neueste Mobiltelefone (Smart Phones), die mittlerweile fast alle mit Kamera, MP3-Player sowie Internet- und Navigationsfunktionen angeboten werden. Dieser Trend zur weiteren Steigerung des Produktnutzens durch die Integration mikro- und nanotechnischer Lösungen führte dazu, dass jetzt auch in weiteren Branchen wie der Sicherheitstechnik, der Energietechnik oder der Medizintechnik eine zunehmende Nachfrage nach Produkten mit miniaturisierter Sensorik, eigenständiger Energieversorgung und standardisierten Kommunikationsfunktionen zu verzeichnen ist.

Grundsätzlich lassen sich dabei zwei wesentliche Trends beobachten, die maßgeblich die weitere Entwicklung der Systemintegrationstechnologien mitbestimmen:

- eine höheren Anzahl an Funktionalitäten, die direkt in einem System vereint werden und neben elektrischen auch optische, mechanische, biologische und chemische Prozesse beinhalten, verbunden mit der Forderung nach einer höheren Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Systeme
- die Integration der Elektronik in das Endprodukt, was eine Anpassung an vorgegebene Materialien, Formen und Anwendungsumgebungen erfordert.

Notwendig sind dafür Integrationstechnologien, die z.B. kleinsten Baugrößen, geringen Verlustleistungen, großen Frequenzbereichen, hohen Zuverlässigkeiten, niedrigen Fertigungskosten und effizienter Testbarkeit auch bei kleinen bis mittleren Stückzahlen Rechnung tragen.

Es werden sich auch die Methoden und Herangehensweisen von Forschung, Produktentwicklung und -fertigung ändern müssen. Bei der Verschmelzung von Elektroniksystem im Endprodukt ist die klassische Wertschöpfungskette nicht mehr geeignet, wettbewerbsfähige Lösungen zu generieren. Für die Baugruppenindustrie gilt es, die bislang weitestgehend als mechanischer und Verdrahtungsträger genutzte Leiterplatte zur variabel ausführbaren Funktionseinheit zu entwickeln. Durch die Verbindung von modernsten Aufbautechnologien und eine enge Kooperation mit dem System-

anwender sind ein anwendungsbezogener Materialeinsatz, optimierte Prozesse, angepasste Testmethoden und eine Lebensdauerbewertung zu vereinigen.

Durch ein in diesem Sinne erweitertes Verständnis der etablierten Basistechnologien ist die Chance gegeben, diesen zugegeben komplexen Ansatz auch kostengünstig zu verfolgen.

Die Konferenz und Fachausstellung „**Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL**“ in Fellbach hat sich auch im Rahmen hochwertiger Baugruppentechologien und zukünftiger Systemintegration als die führende Präsentations- und Diskussionsplattform für Fachleute und Neueinsteiger im deutschsprachigen Raum etabliert. Aktuelle Entwicklungstrends und Praxisergebnisse werden durch Vorträge aus Industrie und Wissenschaft umfassend nutzbar vorgestellt und die Kongressteilnehmer in die Diskussion eingebunden. Die begleitende Ausstellung mit neuesten Geräte- und Prozessentwicklungen ermöglicht eine Einschätzung der Umsetzungsmöglichkeit fortschrittlicher Verfahren und unterstützt zusätzlich den vertieften Erfahrungsaustausch zwischen Forschern, Produktentwicklern und -fertigern sowie Dienstleistern.

Wir würden uns sehr freuen, Sie in Fellbach zu treffen.

Dr. Udo Bechtloff
Vorsitzender Programmkommission

Prof. Dr. Klaus-Dieter Lang
Wissenschaftlicher Tagungsleiter

THEMEN DER TAGUNG

- ◆ Zuverlässiges Systemdesign
- ◆ Leiterplattentechnologien
- ◆ Substrate und Bauelemente
- ◆ Baugruppenfertigung und Verbindungstechnik
- ◆ Ressourceneffiziente Fertigung, Recycling
- ◆ Analyseverfahren, Prozess- und Produktprüfung
- ◆ Entwicklungstendenzen der Systemintegration

APPLIKATIONEN

- ◆ Automobilelektronik
- ◆ Industrieelektronik
- ◆ Medizintechnik
- ◆ Consumerelektronik
- ◆ Kommunikationstechnik
- ◆ Leistungselektronik
- ◆ Sicherheitstechnik
- ◆ Elektronik für Luft- und Raumfahrt

EINREICHUNG VON BEITRÄGEN

Erbeten wird ein ca. 200 Wörter umfassendes Abstract. Die Abstracts werden in einem elektronischen Tool gesammelt, das Sie unter

www.ebl-fellbach.de

finden.

Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden Kriterien aus:

- ◆ Die Arbeit ist neu und wurde an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht.
- ◆ Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit müssen klar beschrieben sein.

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde und erhalten dann eine Schreibenleitung für ihr Manuskript. Das full paper von höchstens sechs Seiten mit vollständigen Autorenangaben reichen Sie dann online als PDF-Datei ein. Bitte verwenden Sie dazu die Rubrik Einreichung von Beiträgen auf der Website der Veranstaltung.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Es wird ein zitierfähiger Tagungsband inklusive CD-ROM erstellt, der den Teilnehmern zur Tagung ausgehändigt wird.

TERMINE

Deadline für Abstracts	15. Juni 2011
Autorenbenachrichtigung	06. September 2011
Abgabe der Papers	14. November 2011

TABLETOP-AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Tagung wird Firmen und Instituten die Möglichkeit geboten, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in einer Tabletop-Ausstellung zu präsentieren. Bitte sprechen Sie uns an und reservieren Sie Ihre Ausstellungsfläche rechtzeitig!